

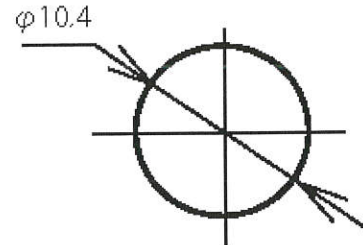
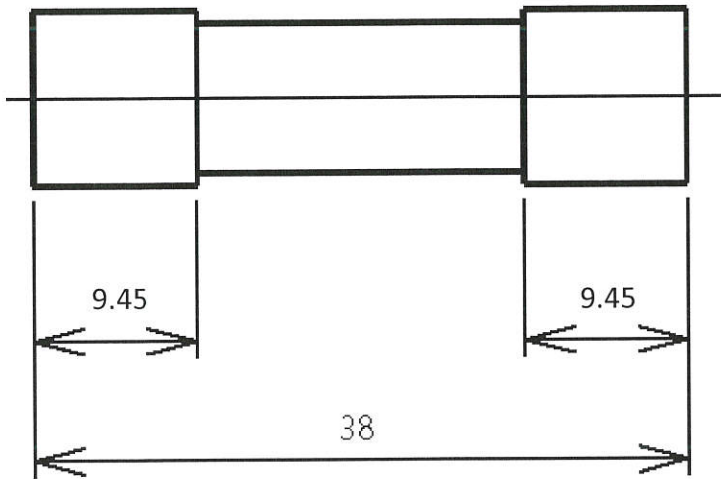
- 4-1. 溶断特性 : 溶断特性カーブ参照 Refer to Time-Current characteristics Curves
- 4-2. 温度上昇 : 温度上昇データ参照 Refer to Temperature Rise Characteristics Curves

5. 形状・外形寸法 および 材質 OUTLINE DRAWING WITH DIMENSIONS AND MATERIAL

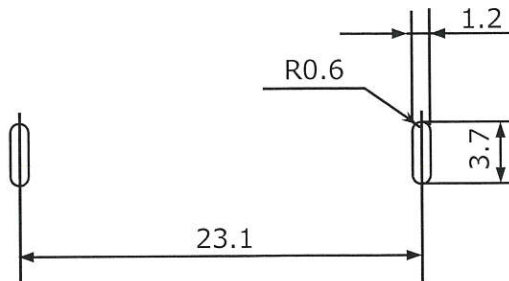
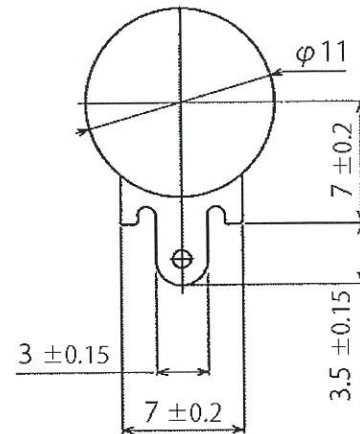
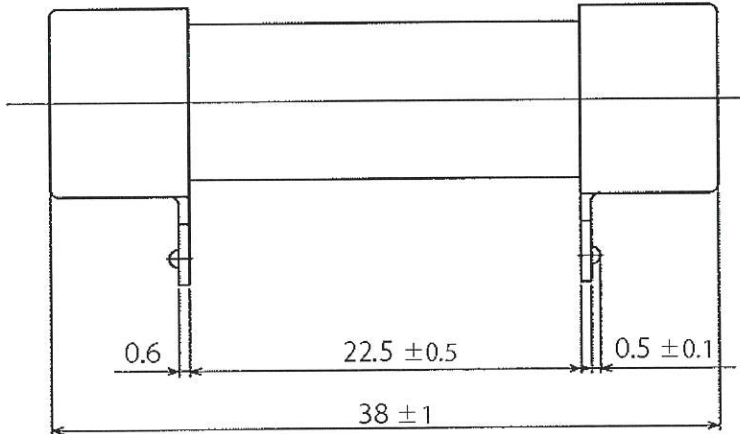
5-1. 形状 : 円筒形ヒューズ Configuration : Tubular Fuse

5-2. 外形寸法 Outline Dimensional Drawing

SSF60 - **U



SSFK60 - **U

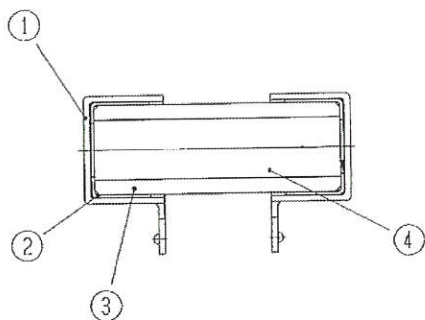


単位: mm
Unit

Recommended Mounting Hole Layout
推奨基板取付穴寸法

Part No.	Revision	Page
☒ SSF60 / SSFK60 - **U	版 A1	2/4

5-3. 構造および材質 Structure and Material



RoHS Compliant
※ RoHS 適合品

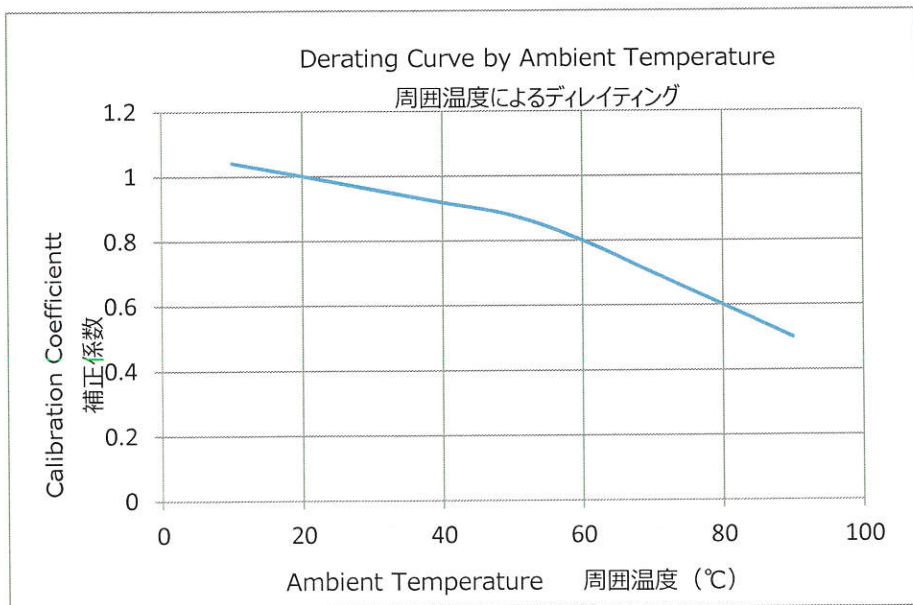
No.	名称	Component	材質	Material
1	外キャップ	Outer Cap	真鍮にニッケルめっき	Brass, Ni plated
2	内キャップ	Inner Cap	真鍮にスズめっき	Brass, Tin plated
3	筒 (本体部)	Body	セラミック	Ceramic
4	充填砂	Filler	結晶シリカ 95%以上	SiO ₂ (≥95%)
5	エレメント	Element	銀	Pure Silver

6. 環境特性 ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

6-1. 使用温度、湿度 Operating Temperature and Humidity

0°C ~ +90°C, 40°C/95% RH 以下 0°C ~ +90°C, ≤ 40°C/95% RH

* 周囲温度における デイレイティング曲線 Ambient Temperature Derating Curves attached.



6-2. 保管条件 Storage Condition

-20°C ~ +40°C, 40°C/95% RH 以下 -20°C ~ +40°C, ≤ 40°C/95% RH

Part No.	Revision	Page
☒ SSF60 / SSFK60 - **U	版 A1	3/4

7. 物理的特性 PHYSICAL SPECIFICATIONS

推奨半田付け条件 Recommended Soldering Parameters

- | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 7-1. | フロー半田 | - 温度 : 250℃~265℃
時間 : 5秒 以内 MAX. | Flow Solder | - Reservoir Temperature
Dwell Time |
| 7-2. | 手半田 | - 半田コテ先温度 : 330℃
時間 : 3秒 以内 MAX. | Manual Soldering | - Soldering Iron Temp.
Dwell Time |

※ コテ先を直接 端子に接触させないこと The tip of soldering iron shall not touch the Terminals.

8. 安全規格 SAFETY STANDARD

取得安全規格 Approvals

Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories

U.L.構成部品プログラム承認 (USR 米国 / CNR カナダ)

U.L.登録番号 : E 360878、ガイドJFHR2 / JFHR8 U.L. File No. : E91958, Guide JFHR2/JFHR8

9. 使用上の注意 CAUTION

Do not put over stress on fuse.

- 9-1. ヒューズには 無理な応力がかからないようにしてください。

Do not apply at 800% of rating by itself for safety.

- 9-2. ヒューズ定格の 800%で遮断する可能性がある場合、危険ですので 単独ではご使用にならないでください。

Do not use outside of range, it may cause fatal damage to equipment.

- 9-3. 使用範囲外でのご使用は製品の損傷に繋がりますので 絶対に行わないでください。

10. その他 OTHERS

In the event that an impropriety is found beyond this Specification, it shall be fixed by mutual agreement between the party.

- 10-1. 使用中、仕様書以外の項目で不具合が生じた場合、両者協議のうえ 決定するものとする。

In the event that an impropriety is found in this Specification, Pico inc. shall amend it by mutual agreement between the party.

- 10-2. 当仕様書に不具合が生じた場合、両者協議のうえ 弊社にて仕様書を改定するものとする。

11. 梱包形態 PACKING

標準梱包数量

SSF60 : 30個 (最大) / 梱包 筒形キャップ端子
SSFK60 : 20個 (最大) / 梱包 PCB実装型端子

Standard Packing Unit

Available in Bulk (M=30pcs/pkg) Ferrule Cap Type
Available in Bulk (M=20pcs/pkg) PCB Terminal Type

標準梱包箱寸法

長さ x 幅 x 高さ = 115 x 47 x 37 mm

Standard Packing Carton Size

Length x Width x Height = 115 x 47 x 37 mm

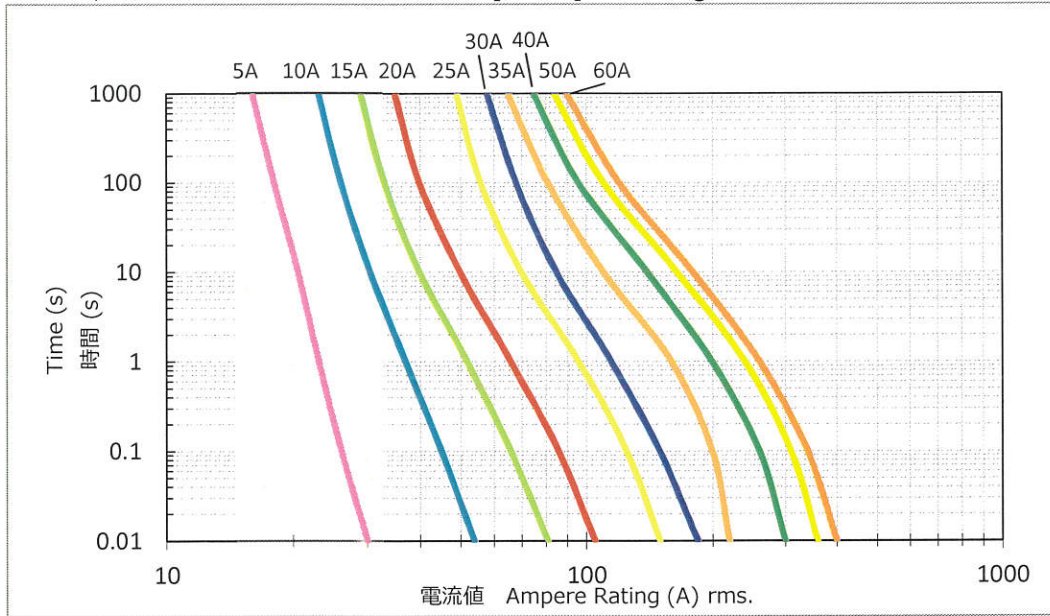
梱包箱材質 : ダンボール

Packaging Material : Cardboard

Part No.	Revision	Page
☒ SSF60 / SSFK60 - **U	版 A1	4/4

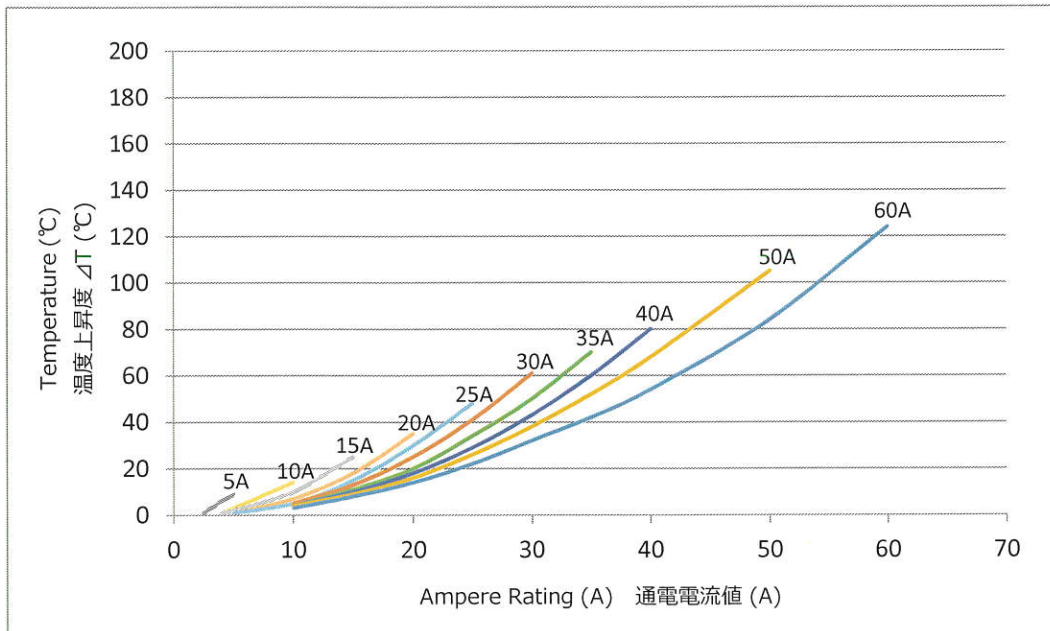
1) 溶断特性 Time-Current Characteristic Curve

SSF60 / SSFK60 Series 平均溶断特性曲線 [参考値] Average Time-Current Characteristics Curve [Ref.]



2) 温度上昇 Temperature Rise

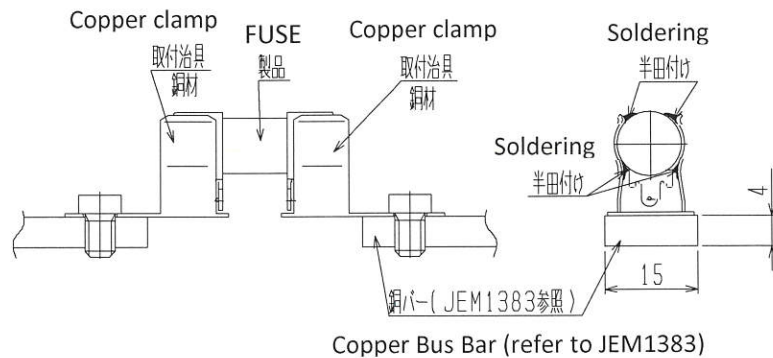
SSF60 / SSFK60 Series 温度上昇 - 測定値 [参考資料] [Ref.] Temperature Rise Measurement



温度測定は本体中央部の温度とする。 Temperature measuring point in the center of the fuse body.

Temperature Rise Measuring method by Thermocouples.

測定条件：右図のように取付温度測定を実施する。



Temperature Rise Test Measuring Method 温度上昇試験 測定状態図

Part No.	Revision	Appendix
図 SSF60 / SSFK60 - **U	版 A1	資料